

GIGABYTE™

技嘉科技

2025 年 投資人說明會

2025/11/14

# Agenda

## 議程

1. 2025 年 Q3 財務報告
2. 策略與展望
3. 產品資訊
4. 企業社會責任
5. Q&A

# 免責聲明

本簡報由技嘉科技有限公司（「技嘉」）準備。由於使用不同的假設和/或不同的標準，本簡報中表達的任何意見如有更改，恕不另行通知。技嘉沒有義務更新或保持此處包含的資訊為最新。對於本簡報的準確性或完整性，本公司現在或將來不會作出任何明示或暗示的陳述或保證，也不承擔任何責任或義務，因此特此明確表示任何責任否認。本簡報中的陳述包括前瞻性陳述，其中包括但不限於有關技嘉的問題、計劃和期望的陳述。前瞻性陳述反映了管理層對未來營運的計劃和目標、對未來事件和未來經濟表現的當前看法以及對各種財務狀況的預測。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果與此類前瞻性陳述明示或暗示的結果有重大差異。

# 2025 年 Q3 財務報告

# 2025/9/30 VS 2024/9/30 資產負債表 Balance Sheet

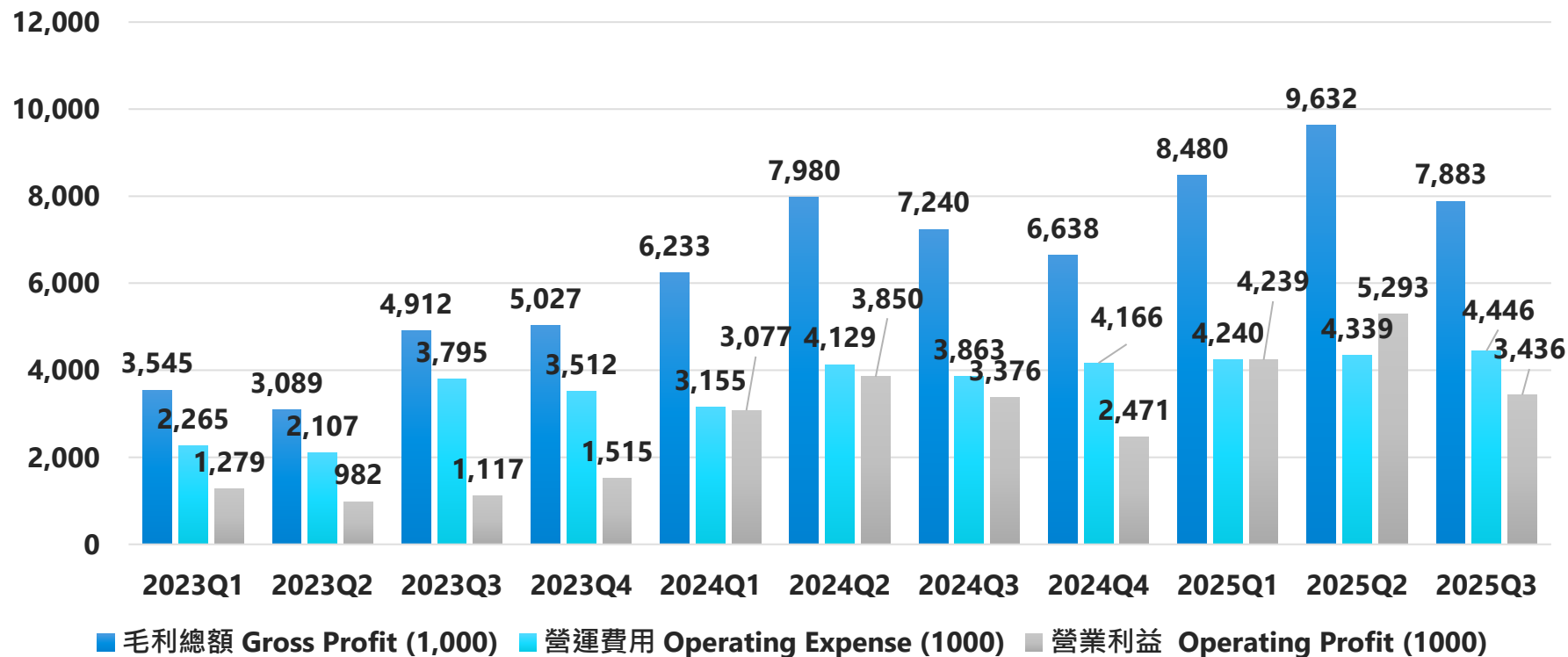
in NT\$100 Mn	2025/9/30	2024/9/30	YoY Growth	YoY %
現金及約當現金 Cash & Equivalents	428.10	325.45	102.65	31.54%
應收帳款 Accounts Receivable	260.13	326.10	-65.97	-20.22%
存貨 Inventories	577.65	442.77	134.88	30.46%
流動資產 Current Assets	1,347.34	1,212.29	135.05	11.14%
固定資產 Fixed Assets	110.6	106.59	4.01	3.76%
資產總計 Total Assets	1,457.95	1,318.88	139.07	10.54%
應付帳款 Accounts Payable	227.43	346.35	-118.92	-34.33%
流動負債 Current Liabilities	782.05	607.71	174.34	28.68%
負債總計 Total Liabilities	885.51	798.83	86.68	10.85%
業主權益 Stockholders ' Equity	554.73	508.11	46.62	9.17%
普通股股本 Paid-in Capital	66.99	66.99		

# 2025年 第三季度 V.S. 2024年 第三季度 損益表 Income Statement

( in NT\$100Mn)	2025 Q3	2024 Q3	YoY Growth	YoY %
營業收入 Net Revenue	795.81	704.45	91.36	12.98%
營業成本 COGS	716.98	632.05	84.93	13.43%
營業毛利 Gross Profit	78.83	72.40	6.43	8.88%
營業費用 Operating Expenses	44.46	38.63	5.83	15.09%
營業利益 Operating Profit	34.36	33.76	0.6	1.77%
稅前淨利 Pre-Tax Profit	40.52	29.91	10.61	35.47%
所得稅費用 Tax	7.78	6.65	1.13	16.99%
本期淨利 Net Profit	32.73	23.35	9.38	40.17%
EPS	4.56	2.91	1.65	56.70%
毛利率 Gross Margin %	9.90%	10.27%	-0.37%	
營業費用率 Operating Expense %	5.58%	5.48%	0.1%	
營業利益率 Operating Margin %	4.31%	4.79%	-0.48%	

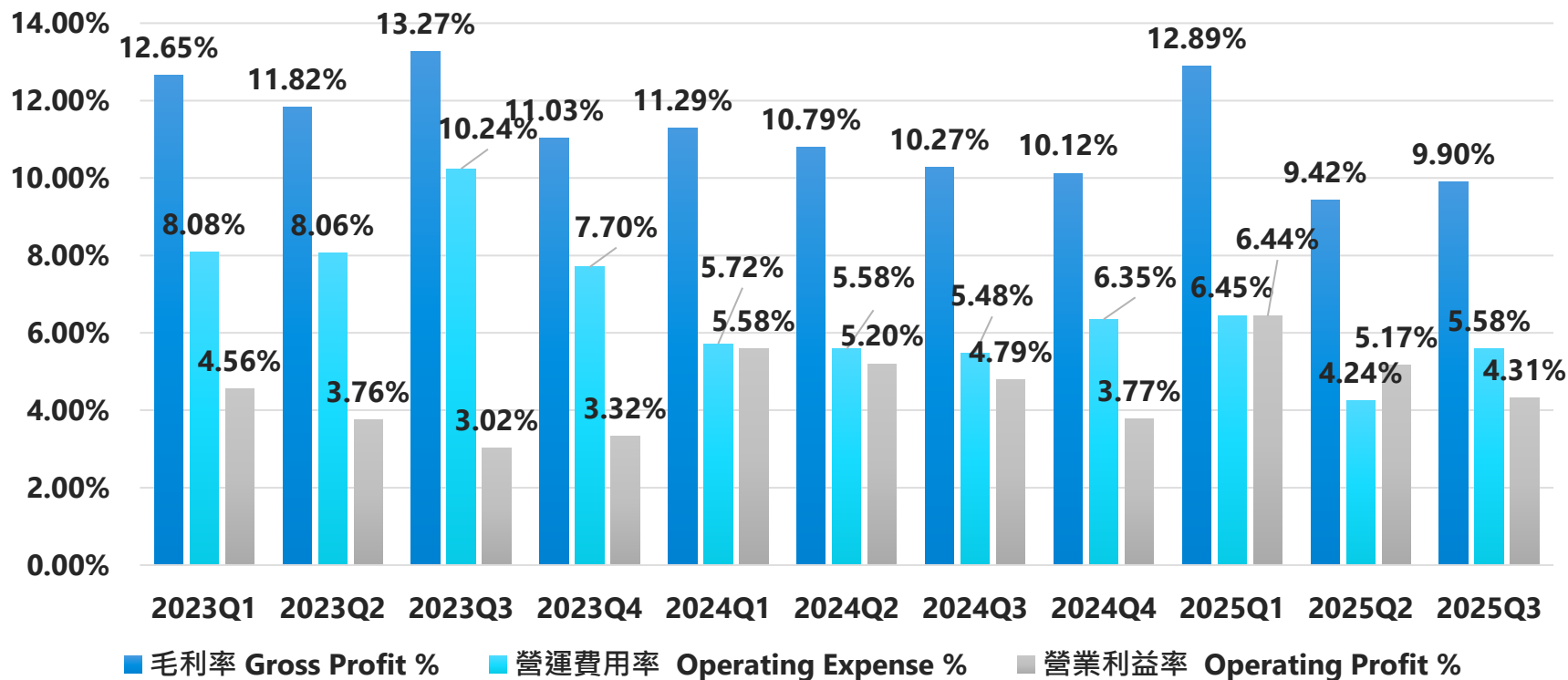
## 2023年 第一季度 至 2025年 第三季度

當季毛利總額 Gross Profit / 營運費用 Operating Expense/ 營業利益 Operating Profit



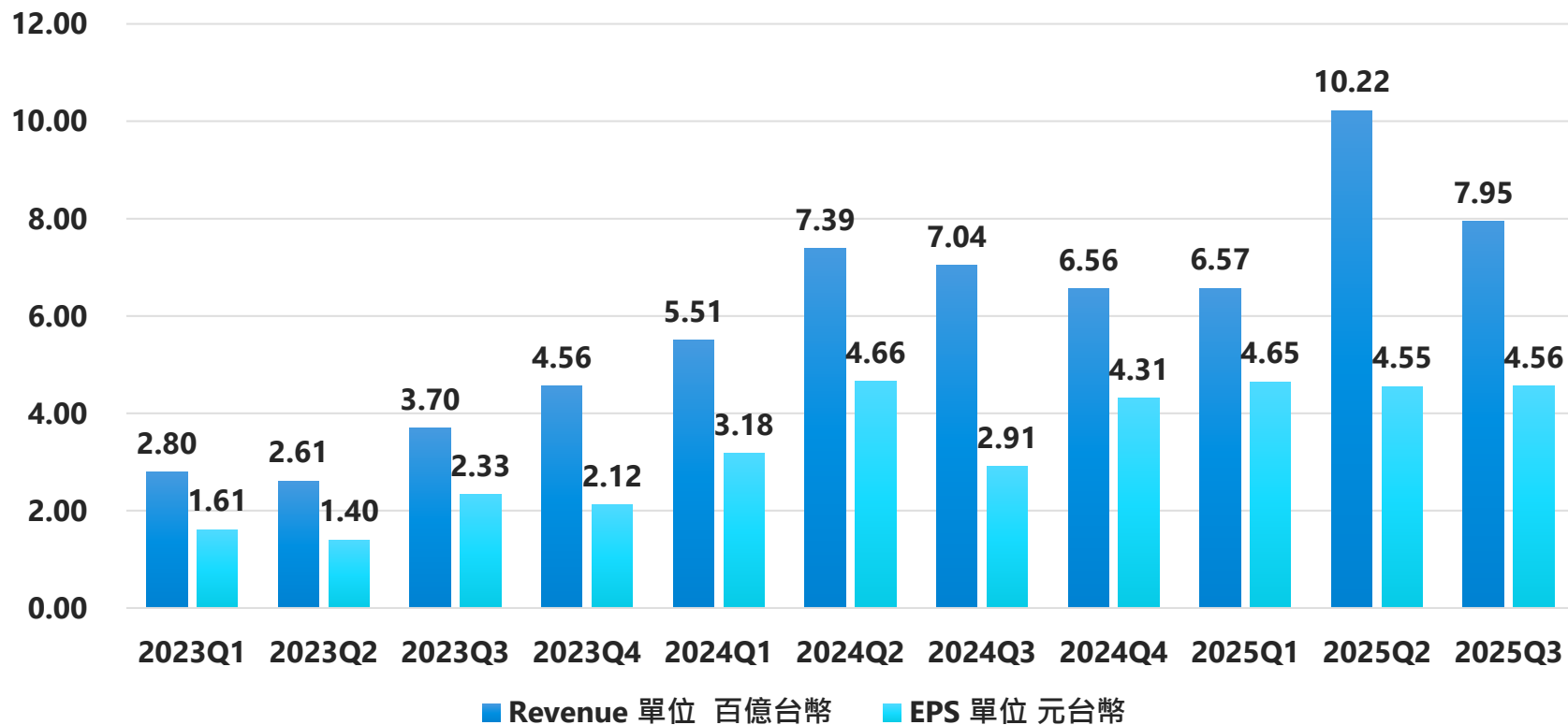
## 2023年 第一季度 至 2025年 第三季度

當季毛利率 Gross Profit % / 營運費用率 Operating Expense % / 營業利益率 Operating Profit %

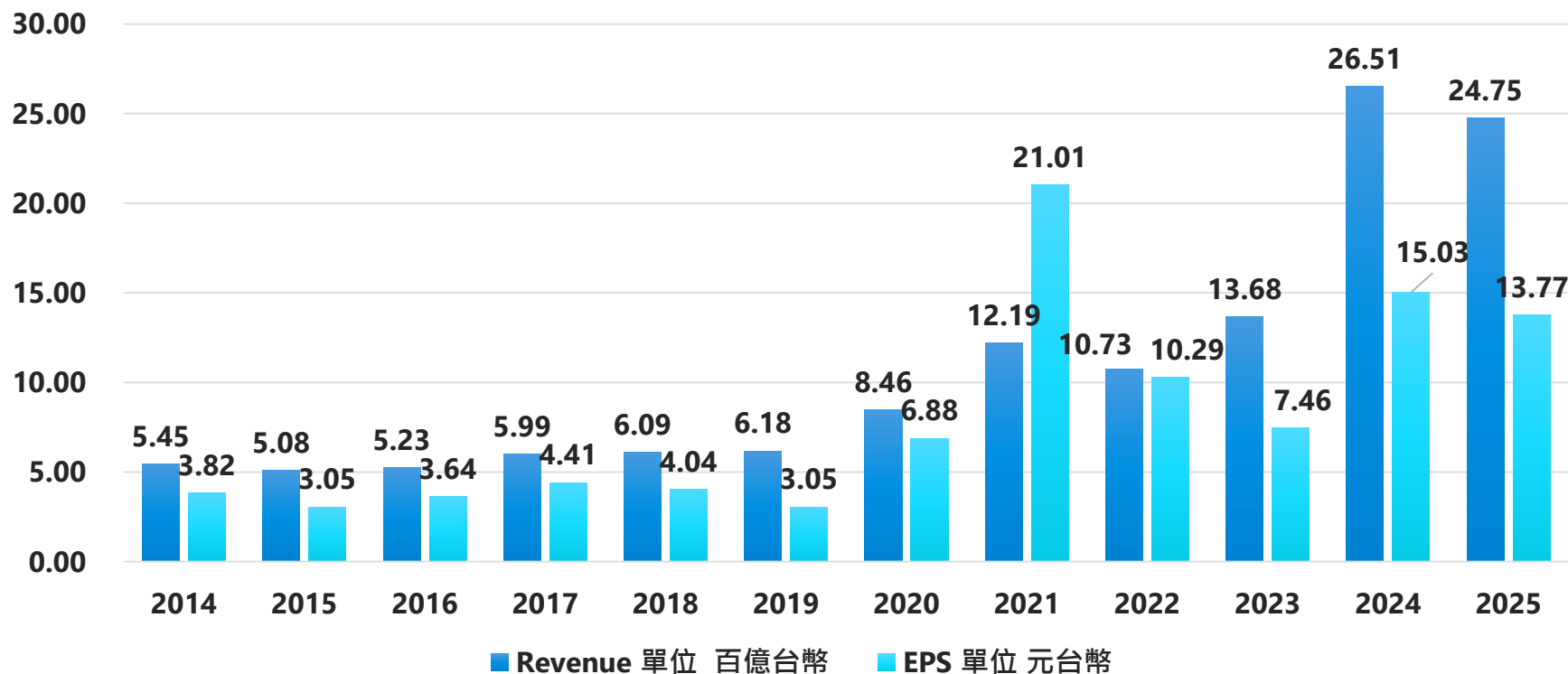




# 2023年 第一季度 至 2025年 第三季度 季營業額及 當季每股盈餘

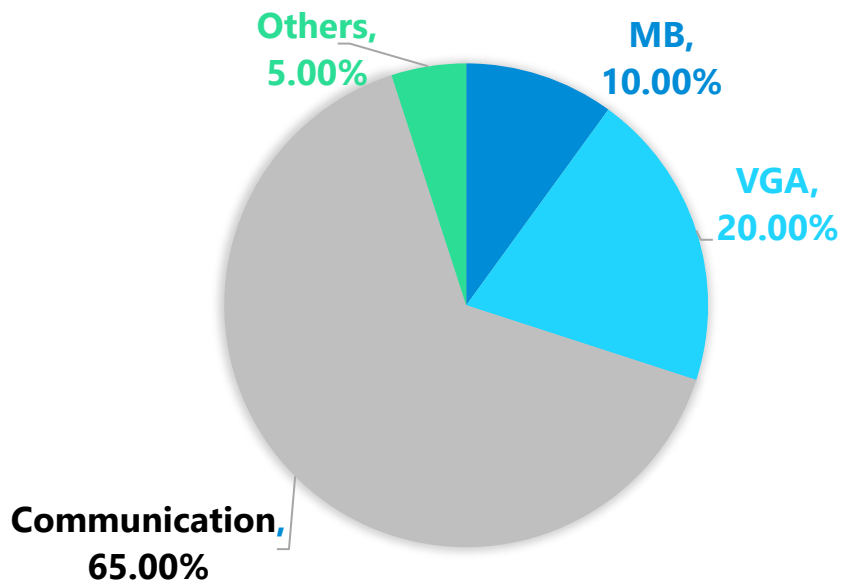


# 2014年 至 2025年 第三季度 年度營業額 及 年度EPS

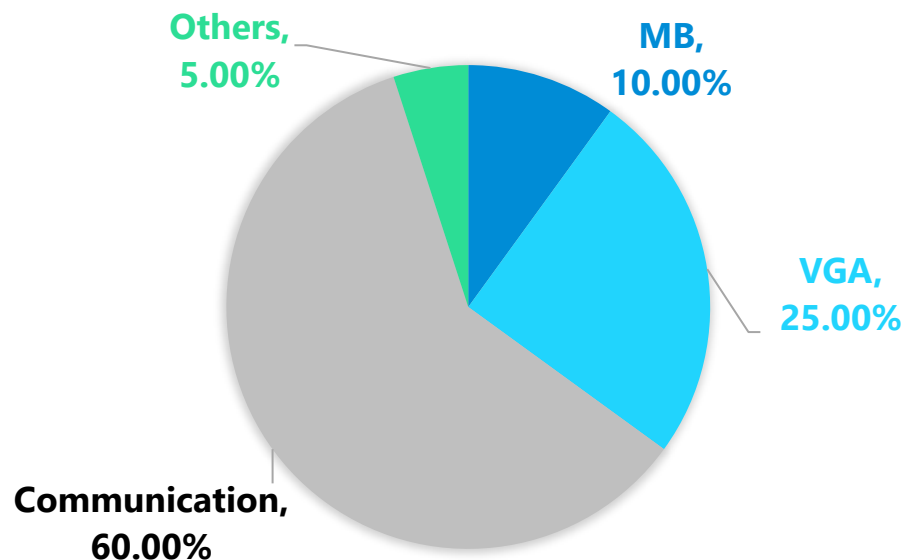


# 2025年 第三季度/ 2024年 第三季度 營收百分比 以產品別

## 2024Q3 Revenue %



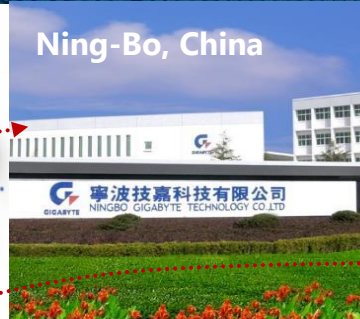
## 2025Q3 Revenue %



# 2025 年 營運重點說明 及 2026年 展望

- 經營績效持續創下歷史新高  
2025年 1-9月 營收新台幣 2,475億 為歷史新高紀錄  
EPS 13.77 僅次於2021年 COVID-19時期 為歷史次高紀錄
- 經濟規模效益展現 2025年營業費用管控得宜  
2025年 1-9月相較 2024年 1-9月 營業費用下降率0.32% (5.58=>5.26% 下降 0.32%)  
2025年 1-9月相較 2024年 1-9月, 營業利益率上升 0.07% (5.16=>5.23% 上升 0.07%)
- 第二季度新台幣匯率劇烈變動影響至七月份 毛利率及匯兌損益八月份起逐漸回歸正常區間
- 2025年三大產品線主機板/顯示卡/伺服器 成長穩健且市場占有率攀升 顯示雖然在地緣政治 關稅政策及匯率動盪造成市場劇烈變動的重大挑戰之下 技嘉所提供的產品 技藝精湛 佳評如潮 深獲全世界消費者喜愛 持續增長
- 技嘉產品全線覆蓋AI雲端到地端市場需求 新產品線陸續加入運營 預期2026年將以雙位數幅度持續成長

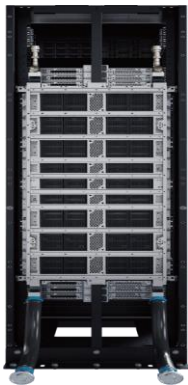
# 因應客戶需求 技嘉全球生產據點及產能持續擴張



# GIGABYTE SERVER SOLUTION

# Blackwell & Next-Gen AI Server Platforms

- GB300 NVL72 : full-stack integration w/ NVSwitch, Grace CPU, and liquid cooling
- W775-V10-L01: liquid-cooled desktop workstation w/ GB300 Superchip
- G894-SD3: 8U HGX B300 with 8× Blackwell Ultra GPUs
- Delivers up to 7× AI training efficiency vs Hopper generation; 2TB+ HBM3e





# GIGABYTE GIGABYTE XL44-SX2-AAS1 NVIDIA RTX PRO

"AI is no longer just a tool — it has become the worker that uses the tools."

- Jensen Huang, NVIDIA CEO



**GIGABYTE™**

**全球正式上市**

整合 NVIDIA RTX PRO™ 6000  
Blackwell 伺服器版本 GPU、  
ConnectX®-8 SuperNIC 交換器  
及 BlueField®-3 DPU

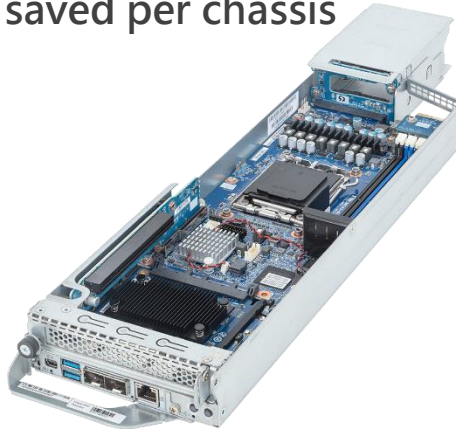


XL44-SX2-AA51



# Blade Portfolio & Sustainability

- B343: 3U blade w/ 10 nodes, EPYC 4005 & Xeon supported
- PCIe Gen5, up to 25GbE, shared PSU & CMC
- >90% recycled plastics & aluminum
- ESG compliant, 30,000 kg CO<sub>2</sub> saved per chassis



# DLC Cooling Collaboration & Progress

## DLC Ready Server

With Thermal coverage

### 1U Rack Server

53.9% Coverage on CPU



### 2U4N Server

62.1% Coverage



### HGX Server

80.2% Coverage



### Blade Server

91% Coverage



## DLC Rack Facility



Passive Cold Plate Loops

Dry-break Quick Connect Couplings



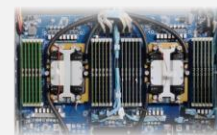
Rack Manifolds



DLC Rack

Power Distribution Units (PDUs)

Leak Sensor Boards



Coolant Distribution Units (CDUs)

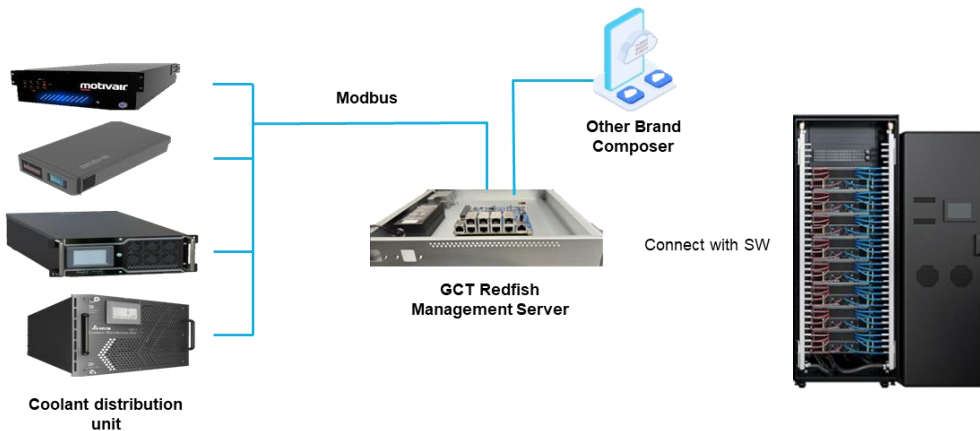


# DLC Cooling Collaboration & Progress



**Liquid to Air CDU / Side Car CDU**

For users who don't have the water facility in data center



**Leak sensor and Management Server**

With deep integration with CDU and sensor in-rack/in-server, providing a piece of mind for leakage protection

# GIGAPOD AI Cluster Solution

- Pre-racked AI system w/ up to 64 GPUs per rack
- Air & DLC options; full-rack deployment ready
- Integrated w/ GPM software (GPU pooling, monitoring)
- Validated in 1.2GW campus (Portugal)



## High Density DLC AI-Pod

42U/48U, 130kW Rack  
8x server per rack  
In-Rack / In-Row CDU



**G4L3/G4L4**

4U H200 / B200/ B300 / MI300X / MI325X/MI355X



**G893 / G894**

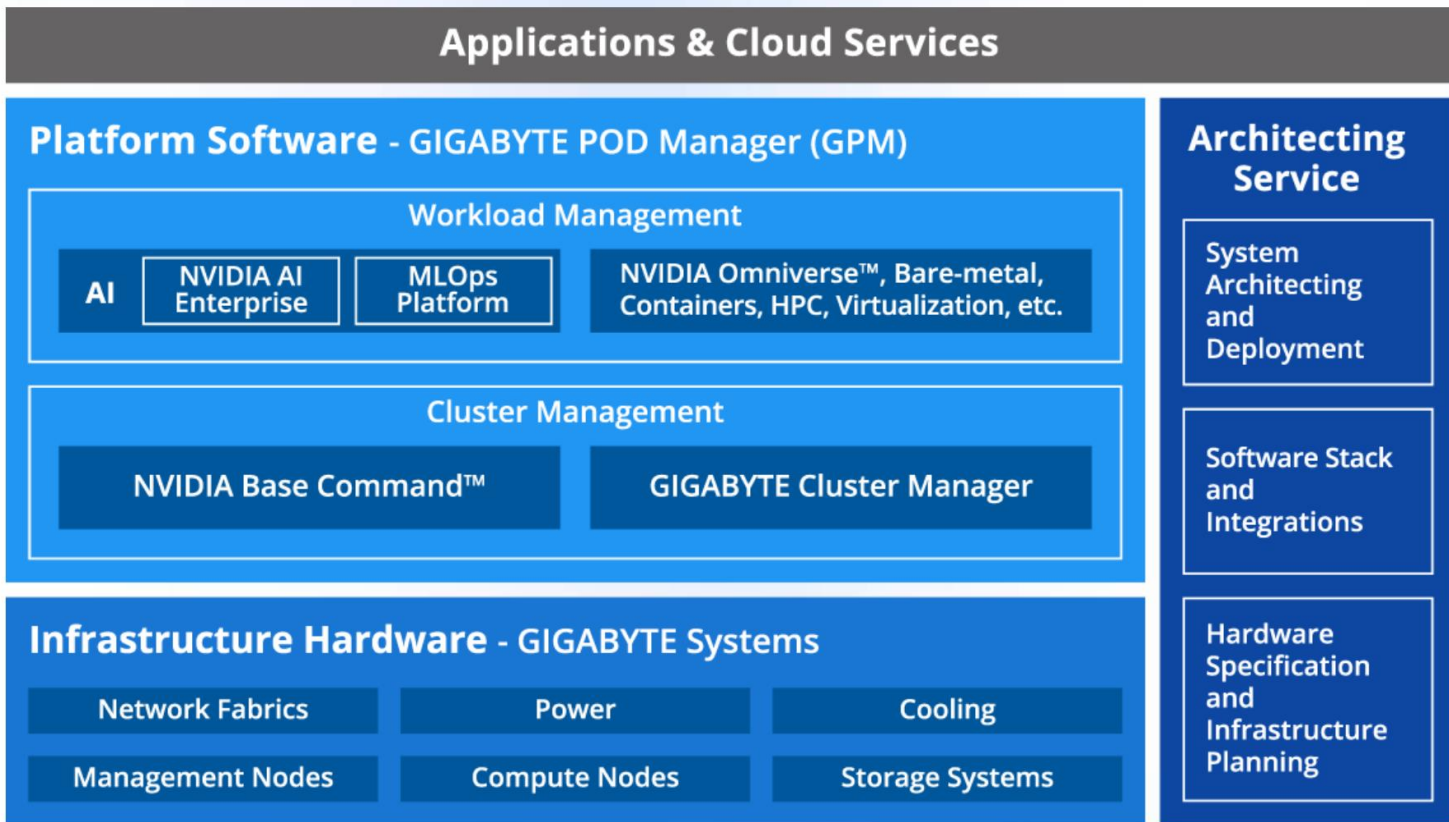
8U Gaudi 3/ B200/ B300/ MI325X / MI350X / MI355X

## Standard Air Cool AI-Pod

42U/48U, 80kW Rack  
4x server per rack  
Option for RDHx



# GPM – GIGAPOD Management Platform

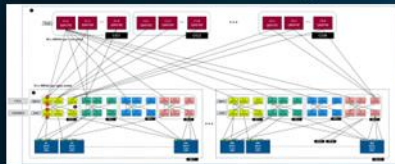




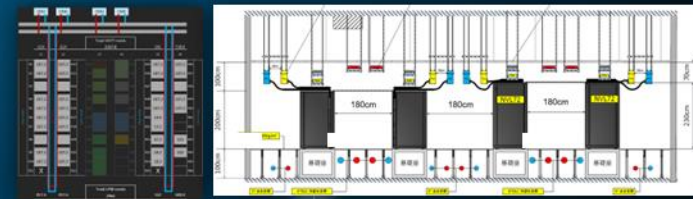
# Infrastructure Architecture & Progress



IB RA network design



Infrastructure design includes placement, cooling and power



Storage network design



POD Manager Platform



# GIGABYTE NOTEBOOK SOLUTION

# GIGABYTE AORUS MASTER 16 榮獲推薦

## 榮獲IGN頒發最佳高階遊戲筆電

### 3. Gigabyte Aorus Master 16

Best High-End Gaming Laptop



#### Gigabyte Aorus Master 16 (2025)

This RTX 5080 laptop offers RTX 5090-like performance for less.



See it at Best Buy

#### PRODUCT SPECIFICATIONS

Display	16-inch (2560×1600) OLED	CPU	Intel Core Ultra 9 275HX
GPU	Up to Nvidia GeForce RTX 5090	RAM	Up to 64GB 5,600MHz DDR5
Storage	Up to 2TB	Weight	5.51lbs
Dimensions	14.05 × 10.0 × 0.90 - 1.14 inches		

## 榮獲BC Award





# AORUS 系列廣獲歐美科技大媒好評

**PC GAMER**

**Laptop**

**PCWorld**

**GAME RANT**

**PC  
MAG**

**CB CREATIVE BLOQ**

gamesradar+

The Verge

tom's **HARDWARE**



**NOTEBOOKCHECK**

**RTINGS.com**

**tom's guide**



# GIGABYTE MOTHERBOARD SOLUTION

# AORUS X870E X3D 系列全新升級

全新改版上市的AORUS X870E X3D 系列，是全球首款專為 AMD Ryzen X3D 處理器量身打造的主機板，搭載 X3D Turbo Mode 2.0，可同時提高遊戲與生產力的效能表現，並以業界領先高達 9000+ MT/s 的 DDR5 記憶體速度、獨家散熱解決方案、EZ-DIY 友善設計與 DriverBIOS技術，為消費者帶來最全面的使用體驗。



# X3D Turbo Mode 2 - 真 AI 超頻革命

「X3D Turbo Mode 2.0」具備強大的遊戲及多工效能。透過主機板內建的獨家 AI 模型及硬體線路，可即時偵測系統負載狀況，動態超頻 X3D 處理器，大幅提升 Ryzen™ X3D 處理器的效能表現。



**專屬硬體加速處理**  
專用硬體模組進行即時效能調校



**動態超頻引擎模型**  
以大量 X3D 處理器數據訓練而成



# AORUS X870 & B850 Stealth 背插主機板

GIGABYTE於2022年首創STEALTH背插系統。新款AORUS X870 & B850 Stealth ICE主機板採用純白設計，線材從背面連接，打造清爽的系統風格。相容超過10家機殼廠商、20款以上機種，簡化裝機與維護流程。STEALTH，重新定義裝機體驗。



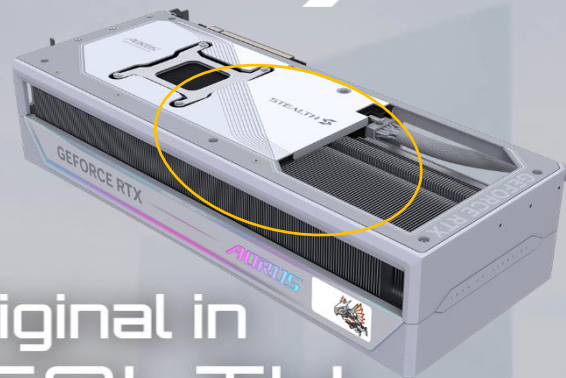
## WOW the AORUS STEALTH

X870 / B850 AORUS STEALTH ICE

GIGABYTE™

# GIGABYTE VGA SOLUTION

# AORUS GeForce RTX™ 5090 STEALTH ICE 32G



Original in  
STEALTH

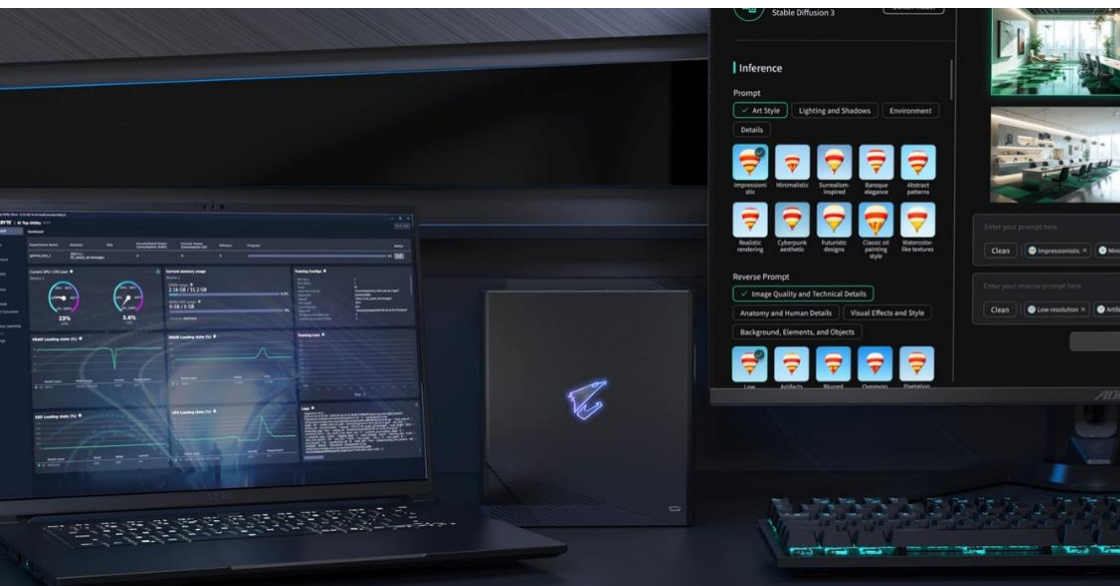
Pioneering Reverse-Connector Design Since 2022



## AORUS AI BOX - 讓輕薄筆電釋放近乎桌機級的顯示卡效能

AORUS RTX 5090 AI BOX 提供頂級效能，讓筆電獲得近乎桌機的最強運算力

AORUS RTX 5060 Ti AI BOX 以精巧體積實現優異的便攜性，讓高效能隨時隨地伴您同行





# Radeon™ AI PRO R9700 AI TOP 32G 顯示卡 - 專為 AI 運算而設計

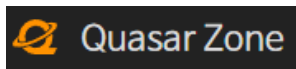
當強大效能  
結合先進 AI

32GB VRAM，專為您實現夢想。



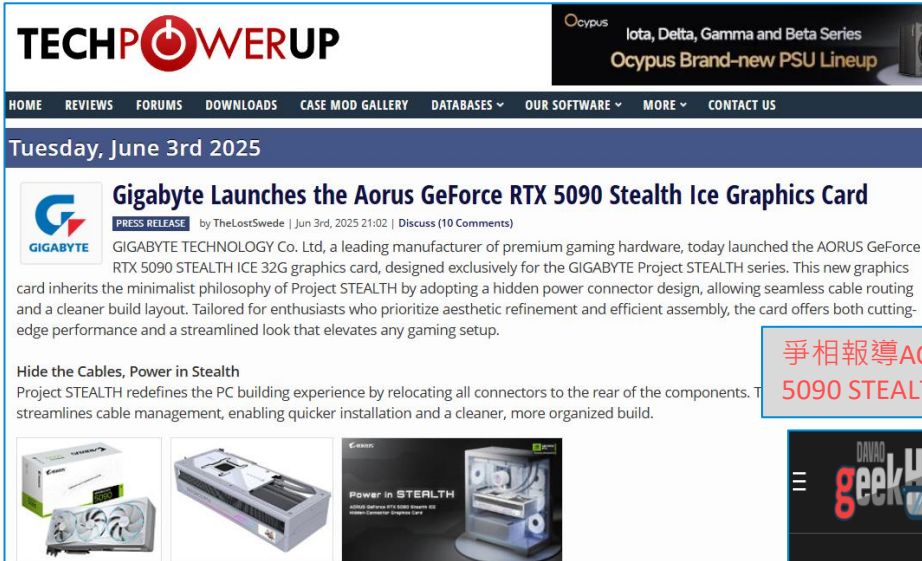
AMD  
RADEON AI  
PRO R9700

# 主流媒體爭相報導



## AORUS RTX 5090 AI BOX 媒體測試多項優點

- + 簡潔的矩形設計
- + 水冷解決方案
- + Thunderbolt 5 · 100 W 充電支持
- + 支援額外的擴充連接埠 ( 支援1個額外的乙太網路連接埠和4個額外的USB連接埠 )
- + 可升級筆記型電腦效能 ( 需要 Thunderbolt 支援 )



爭相報導AORUS GeForce RTX™  
5090 STEALTH ICE 32G 顯示卡



# GIGABYTE AI TOP SOLUTION

# Premium Gaming Desktop, AI Empowered - AI TOP



**AI TOP 500**

**405B – 685B**

研究人員 | 企業單位



**AI TOP 100**

**110B – 200B**

創作者 | 教育工作者 | 小型團隊



**AI TOP ATOM**

**100B – 405B**

開發者 | 創作者

**3000+ 算力**

**1000 算力**

# Premium Gaming Desktop, AI Empowered - AI TOP ATOM

Accelerated by NVIDIA®

**GB10 Superchip**

20-core Arm® CPU &  
Blackwell GPU

128GB

**統一內存架構**

NVIDIA®  
**NVLink™-C2C**

實現 CPU 與 GPU 間  
超高速記憶體通訊



NVIDIA®  
**ConnectX®-7**

雙機互聯 容量翻倍

**NVIDIA DGX OS**

CUDA、PyTorch、TensorFlow  
預載 AI 開箱即用

**AI TOP Utility**

直覺化介面 支援主流 AI 模型



## 技嘉科技 2025 ESG

環境 Environmental  
社會 Society  
公司治理 Governance

# 創新科技，升級你的生活，永續企業與品牌

以2009年為基準年  
溫室氣體排放  
降低 達**51.72%**  
每單位營收的碳排放強度  
提高 **11.3 倍**

承諾讓地球再次  
綠意盎然  
2024年**12,540**棵  
我們種植超過 **115,939** 棵樹木

維持一個清潔和環  
保的企業和供應鏈，  
將水消耗降低  
**34.87%**



舉辦教育研討會等相關活  
動，以傳遞社會與環保意  
識超過**124,788**小時

為培養創新型人才，  
“G-Design” 連續舉辦  
**22 年**

降低企業營運的環境營響，  
減少工業廢物達**0.18%**  
每噸廢物的營收強度  
提高**4.8 倍**

2025年6月技嘉南平廠取得經濟部 產業發展署 綠色工廠認證





# ESG績效



第21屆遠見CSR暨ESG企業社會責任  
獎綜合績效電子科技績優獎  
(連續 9年入圍)



CRIF中華徵信所 亞洲千大企業  
(CRIF Asia TOP1000)



FTSE4Good  
TIP Taiwan ESG Index



臺灣永續指數成分股  
(2023/12/08入選)

MSCI臺灣ESG永續高股  
息精選30指數  
(2023/08/11入選)

特選臺灣ESG低碳50指數  
(2024/12/31入選)

臺灣指數公司特選臺灣  
上市上櫃永續高息中小  
型股指數  
(2024/12/31入選)

## 利害關係人的信賴 是榮譽更是責任

### 環境友善



入選Financial Times 2024  
亞太氣候領袖

114年度綠色工廠認證  
技嘉科技 南平廠

2024  
評比

氣候變遷B  
(連續9年取得管理級以上；  
連續3年領導級)  
供應鏈議合 A-  
水安全B  
(連續3年取得管理級)



子公司百事益國際  
2024新北市綠色消費  
績優企業

### 社會影響力



聯經ASSET人文企業獎  
教育提升獎  
典範獎



勞動部職業安全署  
113年度 企業永續  
報告書揭露  
績優企業

勞動部職業安全署  
113年度 健康勞動  
力永續領航企業  
製造業Top8



1111人力銀行  
2024幸福企業  
科技研發類銀獎

### 幸福職場

### 卓越品質



TAIWAN  
EXCELLENCE  
7項產品榮獲  
33<sup>th</sup>臺灣精品獎



2025年  
4項產品榮獲  
iF 設計獎



reddot design award  
2025年  
7項產品榮獲  
紅點設計獎



# 2025-09-17辦理【減量·共享·愛地球】聯盟供應商大會



## 議題一 因應歐盟CSDDD對企業永續經營之影響與挑戰

技嘉科技 永續發展辦公室 | 朱福政 永續長

說明技嘉科技氣候轉型規劃及歐盟CSDDD並要求供應商未來要求:

1. 供應商皆需簽署人權承諾書，技嘉依風險級別需進行實體到廠稽查。
2. 供應商需進行溫室氣體盤，並設定減碳目標，符合1.5度C之減碳要求路徑。
3. 綠色能源建置需考量環境與生態之考量(for TNFD & SBTN)

最後，說明供應鏈永續管理規範，2025年底將導入系統管理，期望與供應鏈夥伴共築韌性供應鏈。

## 議題二 Biocredits × 產業轉型：共創自然正成長商機

國立臺灣大學森林環境暨資源學系 | 蔡明哲 教授

呼籲供應商該開始行動，與技嘉科技一同共創自然正成長。

說明生物多樣性與氣候變遷關係，包含物種減少、棲地改變、碳吸存能力降低、水循環破壞等。



### 技嘉科技 | 白光華 營運長

感謝供應商歷年來的支持，並提到：「由於技嘉科技及供應鏈不斷成長，未來受到的監管及目光會越來越多，期許能一同建立韌性供應鏈，朝永續經營邁進。」



### 工研院 服科中心 | 陳慧娟 副執行長

推動供應鏈韌性以及供應鏈韌性評量指標

並分享工研院的供應鏈韌性體檢服務平台以及使用結果與案例，期許號召更多廠商加入。



### 毅泰管理 | 王家祥 總經理

分享「循環經濟-邁向淨零的重要路徑」

說明低碳循環解決方案，攜手共創供應鏈碳管理的全新標準與效益。

感謝

Q & A